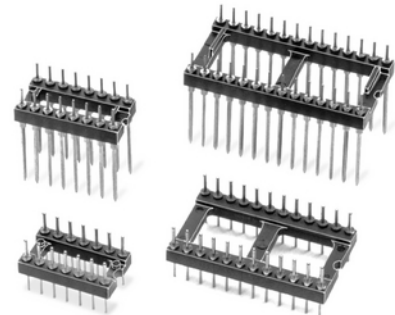


178 / 191 - in Revision

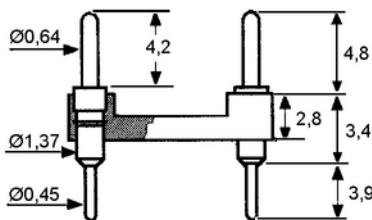
IC-Fassungen / IC-Leisten mit Adapterkontakten Ø 0,64mm
IC Sockets / IC Headers with Ø 0.64mm Adapter Contacts

Technische Daten / Technical Data

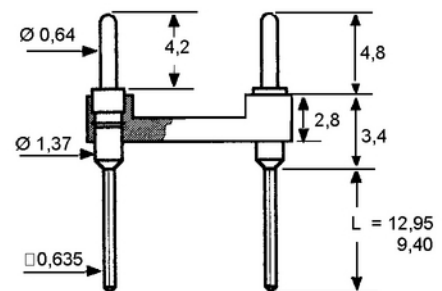
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ <i>< 10mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{RMS} <i>1kV_{RMS}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V _{RMS} / 150V _{DC} <i>100V_{RMS} / 150V_{DC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

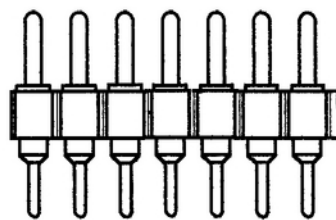
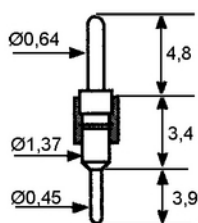


IC-Fassung Serie 178
IC-Socket Series 178

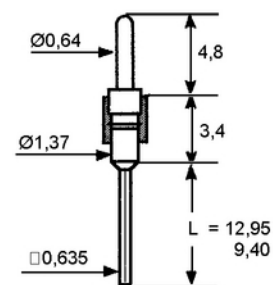


Wire-Wrap Anschluß
Wire-Wrap Type

Einlötanschluß
Solder Type



IC-Leiste Serie 191
IC-Strip Series 191



Series	Contacts*	DIP*	Terminals*	Plating*
178	24	4	10	10
178 IC-Fassungen IC Sockets	06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 28 20 22 24 28 32 10 24 28 32 36 40 42 48 50 52 50 52 64	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=3,90, Ø0,45mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated

Series	Contacts*	Rows*	Terminals*	Plating*
191	16	2	10	10
191 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,60, Ø0,45mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated

* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Löttempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

